

Индивидуальные Корзины Для Очистки Пластин Из Птфэ Держатели Кремниевых Пластин Для Полупроводников Кассеты Из Фторполимера С Низким Фоном

Артикул: PL-CP266



введение

Высокочистые индивидуальные корзины для очистки пластин из ПТФЭ для обработки полупроводников. Разработанные для анализа следовых количеств с низким фоном и устойчивости к агрессивным химическим веществам, эти индивидуальные кассеты из фторполимера обеспечивают нулевое растворение и бесконтактную обработку кремниевых пластин в критически чистых помещениях и промышленных лабораториях.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
RCA-очистка (SC-1/SC-2)	Удаление органических загрязнений, тонких оксидных слоев и ионных примесей с поверхности кремния.	Высокая устойчивость к смесям перекиси водорода и гидроксида аммония.
Травление плавиковой кислотой	Селективное удаление слоев диоксида кремния и пассивация поверхности.	Полная устойчивость к HF, которая в противном случае разрушила бы кварцевые или стеклянные носители.
Обработка пиранин-травлением	Агрессивное удаление тяжелых органических остатков и фоторезиста с использованием серной кислоты и перекиси.	Сохраняет структурную целостность в высокоэкзотермических и окислительных средах.
Поддержка фотолитографии	Обработка пластин во время проявления, удаления и промывки фоторезистных материалов.	Устойчивость к растворителям гарантирует, что носитель не разбухает и не размягчается при воздействии стрипперов.
Промывка после CMP	Критически важная очистка пластин после химико-механической планаризации для удаления абразивных суспензий.	Поверхность с низким образованием частиц гарантирует чистоту пластин после этапа полировки.
Подготовка сложных полупроводников	Специализированная очистка пластин из GaAs, GaN и InP для передовой оптоэлектроники.	Аккуратная поддержка с точными пазами предотвращает повреждение хрупких сложных материалов.
Ультразвуковая/мегасонная очистка	Очистка высокочастотной вибрацией для удаления субмикронных частиц в деионизированной воде.	Свойства материала гасят чрезмерную вибрацию, обеспечивая при этом эффективную передачу энергии.

Категория параметра	Детали спецификации для PL-CP266
Основной материал	Высокочистый ПТФЭ (политетрафторэтилен) / ПФА (перфторалкокки)
Метод изготовления	Высокоточная обработка на станках с ЧПУ (индивидуальное изготовление)
Совместимость с размером пластин	Полностью настраиваемая (Распространенные размеры: 2", 3", 4", 6", 8", 12" или индивидуальные размеры)
Конфигурация пазов	Индивидуальное расстояние, глубина и количество на основе требований процесса

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Категория параметра	Детали спецификации для PL-CP266	
Дизайн ручки	Доступны фиксированные, съемные или интегрированные проушины для подъема (Настраиваемые)	
Химическая стойкость	Отличная (Совместима со всеми кислотами, щелочами и органическими растворителями)	
Диапазон рабочих температур	от -200°C до +260°C (Предел материала; зависит от применения)	
Шероховатость поверхности	Контролируемая отделка после ЧПУ для минимального улавливания частиц	
Фон следовых элементов	Оптимизирован для анализа следовых количеств с низким уровнем (□□□□□□)	
Профиль растворения	Нулевое растворение / Отсутствие выщелачиваемых добавок (□□)	